

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-060

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于子公司通过抵押资产办理银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况概述

苏州同淳新材料科技有限公司（同享科技全资子公司，以下简称“苏州同淳”）因项目建设需要，拟向银行申请授信融资，具体如下：

授信银行名称：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行

授信额度：不超过人民币 2.1 亿元（固定资产抵押贷款额度 1.6 亿元，特定贷款额度 0.5 亿元，特定贷款专项用于项目下开立银行承兑汇票等配套支付结算）

授信期限：5 年

融资方式：抵押加保证方式

项目建设期内，苏州同淳以抵押其位于江苏省苏州市吴江经济技术开发区秀湖西路南侧庞山路东侧的土地（共 40.18 亩）使用权及由同享科技为其提供连带责任担保方式办理授信，待项目完工后，建成的房产一并用于抵押。

在授信有效期内，同享科技董事会授权苏州同淳管理层根据实际情况在前述总授信额度内办理苏州同淳的融资事宜，并担保签署有关与各家银行发生业务往来的法律文件，除相关法律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行召开会议审议。

二、审议和表决情况

2024年4月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议表决通过了《关于子公司通过抵押资产办理银行授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

本次新增银行授信额度事项为满足全资子公司苏州同淳项目建设所需，符合公司整体利益，有利于公司持续稳定地发展，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、备查文件

《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日